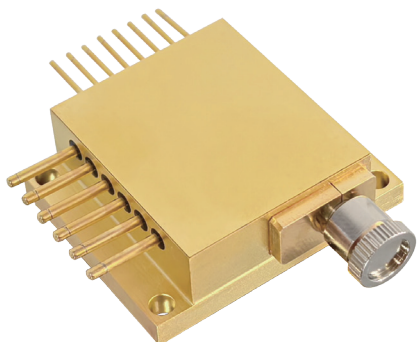


R3M高功率 半导体激光模组



R3M是杏林睿光半导体AW系列多功能激光模组，多波长输出，可集成3种不同波长的主激光。光纤插拔式设计，配置光纤开关、PD光电探测器、RT热敏电阻等功能。

主要功能特点

- ◆ 光斑均匀
- ◆ 功率稳定
- ◆ 散热好
- ◆ 可靠性高
- ◆ 可选不同波长组合输出

应用

光谱检测
生物医疗
材料分析
显示照明
激光制造

技术参数（25℃）

封装形式		R3M					
		三波长			三波长		
中心波长（nm）		650	808	9XX / 1064	650	980	1470
光学	连续输出功率 P_{op} （W）	0.5	12	15 / 10	0.5	15	4
	波长公差（nm）	± 10					
	光谱宽度 $\Delta\lambda$ （nm）	< 6					
	波长随温度特性 $\Delta\lambda/\Delta T$ （nm/℃）	0.3					
电学	阈值电流 I_{th} （A）	0.5	1.8	1 / 1.2	0.5	1	1.4
	工作电流 I_{op} （A）	1.2	16	18 / 13	1.2	18	14
	工作电压 V_{op} （V）	2.3	2	1.8 / 1.8	2.3	1.8	1.5
	微分效率 η_{es} （W/A）	0.7	0.9	0.9 / 0.8	0.7	0.9	0.3
	PD电流 I_{pd} （ μA ）	< 8000					
	热敏电阻参数 R_t （ $k\Omega/\beta$ （25℃））	$10 \pm 1\%/3930$					
光纤	光纤芯径 D_{core} （ μm ）	400					
	光纤包层直径 D_{clad} （ μm ）	440					
	光纤涂覆层直径 D_{buffer} （ μm ）	720					
	数值孔径 NA	0.22					
	连接器	SMA905					

注：1. 以上表格内所有数据均为室温25℃环境下测试所得的典型值，最终数据以出厂测试报告为准。

其他参数

参数	工作温度（℃）	工作相对湿度（%）	存储温度（℃）	存储相对湿度（%）	引脚焊接温度（max/℃）
最小	10	-	-20	-	-
最大	30	75	70	90	250(10Sec.)

